

RJ45C5E S1U DE4G/Y RL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La gamme de produit comprend les conceptions suivantes :

- 90°, couché (horizontal) et 180°, debout (vertical)
- verrouillage / déverrouillage
- Systèmes de soudure THT, THR ou SMD
- Large gamme de formes, également avec des LED intégrées et des languettes de contact blindage
- Catégorie de puissance Cat. 3 à Cat. 6
- Version emballée sur plateau (TY) ou en rouleau (Tape-on-Reel, RL)
- Compatible avec le connecteur modulaire RJ45, selon ANSI / TIA-1096-A et CEI 60603
- Rigidité diélectrique ≥ 1500 V AC RMS (2250 V AC valeur crête) selon IEEE 802.3
- Rigidité diélectrique ≥ 1500 V AC (valeur crête) ou ≥ 1500 V DC selon CEI 60603

Propriétés et avantages :

- Plage de température étendue de -40 °C à $+85$ °C pour une puissance maximale
- Couche d'or renforcée (30μ) pour une protection contre la corrosion améliorée
- Une distance minimale de 0,3 mm garantit une soudure parfaite

Informations générales de commande

Version	Connecteur pour circuit imprimé, Prises RJ45, Cat. 5e , Raccordement soudé SMD, 90°, Option de verrouillage: haut, Languettes de blindage: 6 tabs, 30...80 μ " Ni / ≥ 30 μ " Au , LED: Oui, vert, jaune, Nombre de pôles: 12, Tape
Référence	2562890000
Type	RJ45C5E S1U DE4G/Y RL
GTIN (EAN)	4050118571912
Qté.	200 pièce(s)
Emballage	Tape

RJ45C5E S1U DE4G/Y RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	15,7 mm	Profondeur (pouces)	0,618 inch
Hauteur	14,71 mm	Hauteur (pouces)	0,579 inch
Hauteur version la plus basse	13,41 mm	Largeur	18,8 mm
Largeur (pouces)	0,74 inch	Poids net	0,009 g

Classifications

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ECLASS 9.0	27-44-04-02
ECLASS 9.1	27-44-04-02	ECLASS 10.0	27-44-04-02
ECLASS 11.0	27-46-02-01	ECLASS 12.0	27-46-02-01

Propriétés électriques

Courant nominal	1,5 A	Rigidité diélectrique, contact - blindage	1500 V DC
Rigidité diélectrique, contact - contact	1000 V DC	Tension nominale	125 V
Tenue d'isolation	≥ 500 MΩ		

Standards

Norme de connecteur	CEI 60603-7-51
---------------------	----------------

Caractéristiques du système

Angle de sortie	90°	
Blindage	Oui	
Catégorie	Cat. 5e	
Catégorie de puissance	Cat. 5e	
Circuit	8 brins	
Coplanarité :	100 µm	
Couleur LED droite	jaune	
Couleur LED gauche	vert	
Cycles d'enfichage	750	
Degré de protection	IP20	
Diamètre du trou d'implantation (D)	0,9 mm	
Famille de produits	Données OMNIMATE - Prise modulaire RJ45	
LED	Oui	
Languettes de blindage	6 tabs	
Longueur du picot à souder (l)	3,7 mm	
Matériau de blindage	Laiton	
Montage sur le circuit imprimé	Raccordement soudé SMD	
Nombre de picots par pôle	1	
Nombre de pôles	12	
Option de verrouillage	haut	
Pas en mm (P)	1,27 mm	
Pas en pouces (P)	0,05 inch	
Surface de blindage	nickelé	
Système de soudure	Soudure par refusion, Soudure manuelle	
Tolérance du diamètre du trou d'implantation (D)	± 0,1 mm	
Tolérance sur la longueur du picot à souder	Tolérance supérieure avec préfixe (tableau de baie minimale)	-0,2
	Tolérance supérieure avec préfixe (tableau de baie maximale)	+0,02
	Tolérance, unité	mm

Date de création 7 novembre 2022 14:04:35 CET

RJ45C5E S1U DE4G/Y RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Tolérance sur la longueur du picot à souder	+0,02 / -0,2 mm
Tolérance sur la position du picot à souder	± 0,15 mm
Type de raccordement	Raccordement soudé SMD

Données des matériaux

Matériau isolant	PA 9T	Couleur	noir
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 9011	Groupe de matériaux isolants	II
Indice de Poursuite Comparatif (CTI)	≥ 500	Tenue d'isolation	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau de base du contact	Bronze phosphoreux	Surface du contact	Or sur nickel
Structure en couches du contact mâle	30...80 μ" Ni / ≥ 30 μ" Au	Température de stockage, min.	-40 °C
Température de stockage, max.	85 °C	Température de fonctionnement, min.	-40 °C
Température de fonctionnement, max.	85 °C		

Emballage

Emballage	Tape	Longueur VPE	0 m
Largeur VPE	0 m	Hauteur VPE	0 m
Diamètre de bobine du ruban Ø (A)	330 mm	Résistance de la surface	Rs = 10 ⁹ - 10 ¹² Ω

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
Certificat N° (UL)	E471884
Certificat N° (cULus)	E471884

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	Certificate of Compliance
Catalogue	Catalogues in PDF-format

RJ45C5E S1U DE4G/Y RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

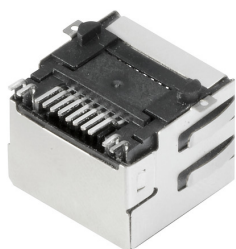
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins



RJ45C5E S1U DE4G/Y RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

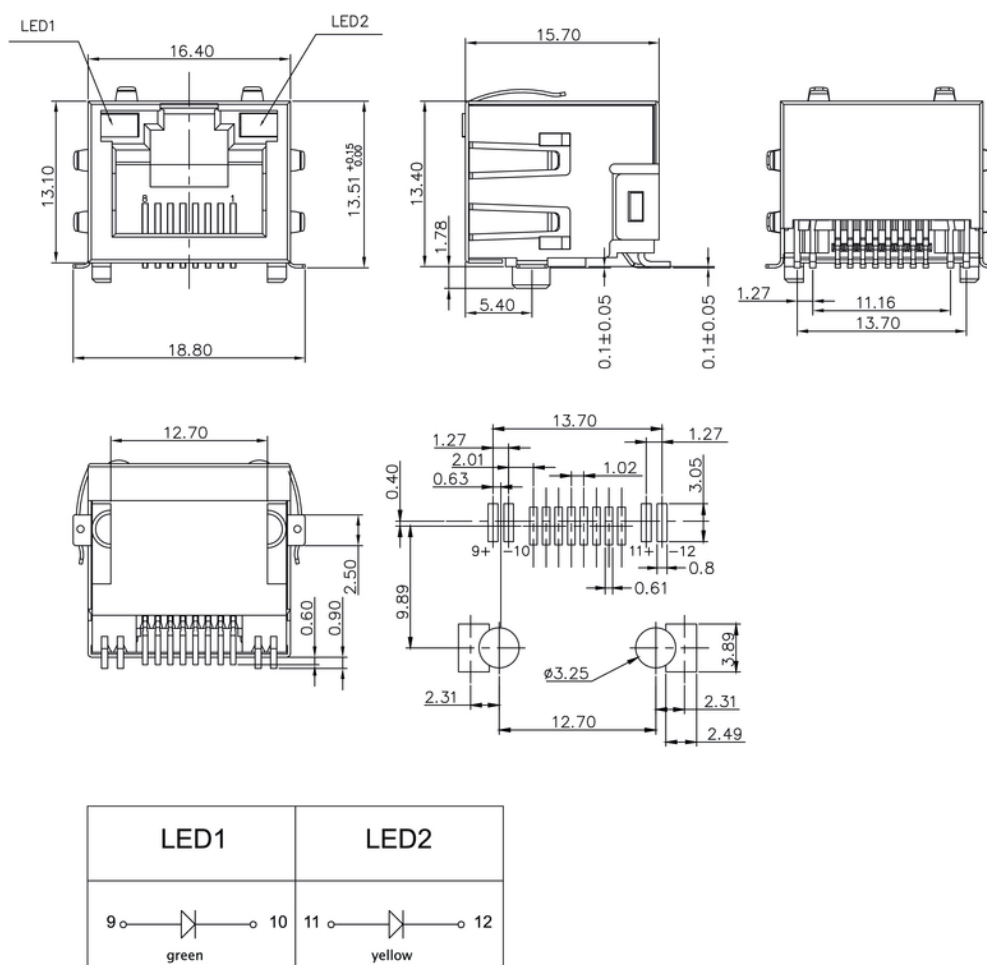
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dimensional drawing



RJ45C5E S1U DE4G/Y RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

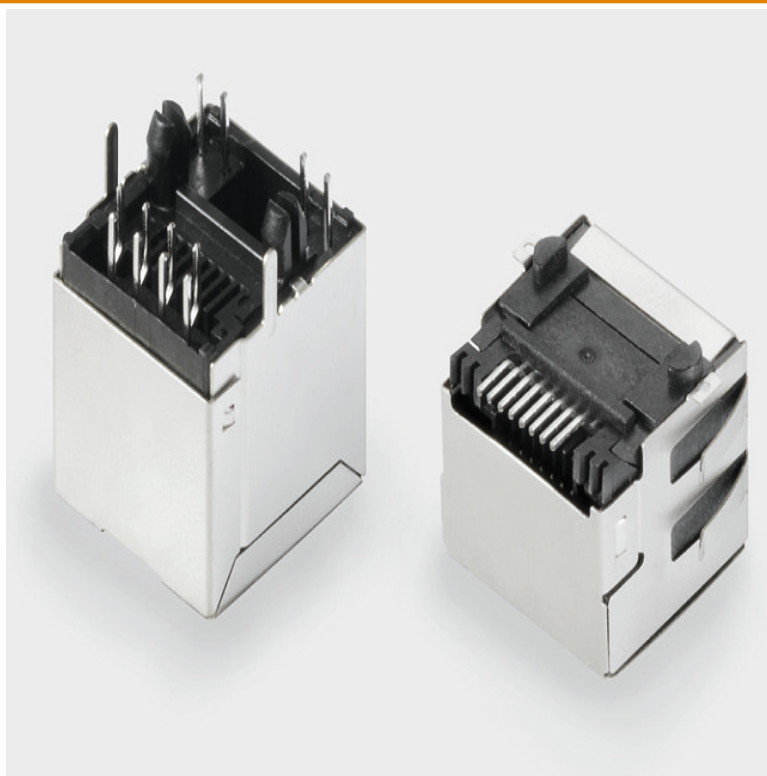
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Avantages du produit



Trouble-free assembly
Short, chamfered solder pins

RJ45	G1	R1	U	3.2	E	4	GY/GY	TY	RJ45G1 R1U 3.2E4GY/GY TY
									</

Légende

Date de création 7 novembre 2022 14:04:36 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.